

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-073

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。集成电路测试中心大楼已完工并投入使用，公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作，使用情况良好。对于剩余部分仪器设备，公司将结合产品的研发测试进展，进行同步规划与动态部署，调整后项目实施期限延长至2027年12月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03元/股，本次发行募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币54,449.71万元。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号），验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

2023 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金实际情况，将“集成电路材料测试中心项目”的拟使用募集资金投入金额由 45,000.00 万元调整为 28,372.88 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-001）。

经上述调整后，募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前拟使用募集资金投入金额	调整后拟使用募集资金投入金额
1	年产 12,000 吨半导体专用材料项目	25,000.00	21,076.83	21,076.83
2	集成电路材料测试中心项目	45,000.00	45,000.00	28,372.88
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计		75,000.00	71,076.83	54,449.71

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12,000 吨半导体专用材料项目”已结项，公司将该项目节余募集资金 2,549.63 万元（实际金额以资金转出当日结项募集资金投资项目专用账户余额为准）用于募集资金投资项目“集成电路材料测试中心项目”，该项目募集资金投资金额将由 28,372.88 万元增加至 30,922.51 万元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

目的公告》（公告编号：2024-012）。

（二）募集资金投资项目的募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	调整后拟使用募集资金投入金额	截至 2025 年 10 月 31 日募集资金累计投入金额	投入进度	项目状态
1	年产 12,000 吨半导体专用材料项目	18,592.45	18,592.45	100.00%	已结项
2	集成电路材料测试中心项目	30,922.51	19,180.31	62.03%	进行中
3	补充流动资金	5,000.00	5,009.46	100.19%	已结项

截至 2025 年 10 月 31 日，“集成电路材料测试中心项目”已使用募集资金 19,180.31 万元，募集资金使用进度为 62.03%。

（三）募集资金存放及在账情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金余额为 12,415.48 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：使用闲置募集资金投资结构性存款的余额为 9,000 万元，募集资金专项账户余额为 3,415.48 万元。

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合公司目前募集资金投资项目的实际建设情况和投入进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	募集资金投资项目	原计划预计可使用状态日期	调整后预定可使用状态日期
1	集成电路材料测试中心项目	2025 年 12 月	2027 年 12 月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因及延期后保障措施

自首次公开发行股票募集资金到位以来，公司一直积极推进“集成电路材料测试中心项目”的实施。“集成电路材料测试中心项目”聚焦对半导体光刻胶、电镀液及配套试剂进行研发、测试与性能评价，不涉及产能建设，拟建设测试中心大楼，并配备行业先进水平的实验测试设备，打造国内一流的集成电

路关键材料研发测试平台。

截至目前，集成电路测试中心大楼已完工并投入使用，公司已顺利完成多个产品测试平台的仪器配套与调试工作，使用情况良好。对于剩余部分仪器设备，公司结合半导体行业技术进步情况及产品研发测试进展对仪器设备购买安排进行灵活调整，由于涉及较多类型的精密设备及仪器，相关设备投资金额大，设备安装与调试周期长，且部分进口设备受到国际贸易摩擦和关税壁垒等外部因素的影响，项目预计无法在原定计划时间内完成全部工作。

为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，控制募集资金的使用风险，公司据此审慎决定调整募集资金投资项目期限。后续，公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，结合行业技术进步与公司业务发展实际，对募集资金投资项目的建设进度进行合理统筹，确保项目有序高效推进。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据经营发展需要和项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变化，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、投资用途及投资规模，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、履行的审议程序

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“集成电路材料测试中心项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后预定可使用状态日期延长至2027年12月。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025年11月29日